

Title (en)  
Grounding module

Title (de)  
Erdungsmodul

Title (fr)  
Module de mise à la masse

Publication  
**EP 0802583 A2 19971022 (DE)**

Application  
**EP 97104914 A 19970322**

Priority  
DE 19617114 A 19960419

Abstract (en)  
The earthing module has an earthing plate (9) which can be optionally connected on both sides to a conventional blade clamp connecting contact with angled lead-ins (3) or a threaded contact (4) connection, or on one side with a blade clamp connecting contact and on its other side with a threaded contact connection. The earthing plate consists of multiple angled contact springs (11) which are brought together in the centre and form a contact region with three contact vanes (12-15), whereby the contact vanes are angled upwards from the central contact region.

Abstract (de)  
Die Erfindung bezieht sich auf ein Erdungsmodul zum Anschließen von Erdungsleitern an Kontaktelemente und zum Aufrasten auf Schienen. Die Aufgabe der Erfindung, ein Erdungsmodul zu entwickeln, mit dem ein schnelles, bequemes und zuverlässiges Anschließen und Lösen von einem oder von mehreren Erdungsleitern für eine große Bandbreite von Drahtdurchmessern gewährleistet ist, wird dadurch gelöst, daß ein Erdungsblech 9 auf beiden Seiten wahlweise mit einem bekannten Schneid-Klemm-Anschlußkontakt mit Einlaufschräge 3 über dessen Mittelabgriff 15 oder mit einem Schraubkontakt-Anschluß 4 oder auf seiner einen Seite mit einem Schneid-Klemm-Anschlußkontakt mit Einlaufschräge 4 über dessen Mittelabgriff 15 und auf seiner anderen Seite mit einem Schraubkontakt-Anschluß 4 verbunden ist. <IMAGE>

IPC 1-7  
**H01R 9/26**

IPC 8 full level  
**H01R 9/26** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**H01R 9/2691** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0802583 A2 19971022; EP 0802583 A3 19991117**; AU 1663497 A 19971023; AU 714488 B2 20000106; BG 101398 A 19971128; BG 62673 B1 20000428; DE 19617114 A1 19971023; DE 19617114 C2 19980507; IL 120525 A0 19970713; JP H1083851 A 19980331; PL 319473 A1 19971027; US 5928008 A 19990727

DOCDB simple family (application)  
**EP 97104914 A 19970322**; AU 1663497 A 19970401; BG 10139897 A 19970409; DE 19617114 A 19960419; IL 12052597 A 19970325; JP 8626697 A 19970404; PL 31947397 A 19970414; US 84395597 A 19970418